

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制



芯联集成电路制造股份有限公司及其子公司拟进行技术授权所涉及的
芯联集成电路制造股份有限公司及其子公司持有的部分资产
资产评估报告

金证评报字【2026】A0533号
(共一册, 第一册)



金证(上海)资产评估有限公司

2026年6月6日

中国资产评估协会

资产评估业务报告备案回执

报告编码:	3132020024202600348
合同编号:	金证合同字【2026】A06027号
报告类型:	法定评估业务资产评估报告
报告文号:	金证评报字【2026】A0533号
报告名称:	芯联集成电路制造股份有限公司及其子公司拟进行技术授权所涉及的芯联集成电路制造股份有限公司及其子公司持有的部分资产评估报告
评估结论:	908,700,000.00元
评估报告日:	2026年06月06日
评估机构名称:	金证(上海)资产评估有限公司
签名人员:	林骁 (资产评估师) 正式会员 编号: 31180075 龚玮 (资产评估师) 正式会员 编号: 31230025
林骁、龚玮已实名认证	
	
(可扫描二维码查询备案业务信息)	

说明: 报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案, 不作为协会对该报告认证、认可的依据, 也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责任的依据。

备案回执生成日期: 2026年06月08日

ICP备案号京ICP备2020034749号

目 录

声 明	2
摘 要	3
正 文	5
一、 委托人、产权持有人和其他资产评估报告使用人概况	5
二、 评估目的	7
三、 评估对象和评估范围	7
四、 价值类型	11
五、 评估基准日	11
六、 评估依据	11
七、 评估方法	13
八、 评估程序实施过程和情况	13
九、 评估假设	14
十、 评估结论	15
十一、 特别事项说明	16
十二、 资产评估报告使用限制说明	17
十三、 资产评估报告日	17
附 件	19

声 明

一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。

二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。

本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对其评估对象可实现价格的保证。

三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。

四、评估对象涉及的资产清单及收入预测由委托人、产权持有人申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。

五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。

六、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。

七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

芯联集成电路制造股份有限公司及其子公司拟进行技术授权所涉及的

芯联集成电路制造股份有限公司及其子公司持有的部分资产

资产评估报告

摘要

特别提示：本摘要内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。

金证（上海）资产评估有限公司接受芯联集成电路制造股份有限公司及芯联先进集成电路制造（绍兴）有限公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用收益法，按照必要的评估程序，对芯联集成电路制造股份有限公司、芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司、芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司拥有的部分无形资产在 2026 年 4 月 30 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况摘要如下：

委托人：芯联集成电路制造股份有限公司及芯联先进集成电路制造（绍兴）有限公司。

产权持有人：芯联集成电路制造股份有限公司、芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司、芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司。

经济行为：芯联集成电路制造股份有限公司及其子公司拟技术授权其拥有的部分无形资产。

评估目的：技术授权。

评估对象：芯联集成电路制造股份有限公司、芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司、芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司拥有的部分无形资产。

评估范围：芯联集成电路制造股份有限公司、芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司、芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司拥有的专利权 66 项、专有技术 30 项。

价值类型：市场价值。

评估基准日：2026 年 4 月 30 日。

评估方法：收益法。

评估结论：经评估，本次评估范围所涉及的部分资产于评估基准日的市场价值合计为人民币 90,870.00 万元，大写玖亿零捌佰柒拾万元整。其中，芯联集成持有部分为 31,810.00 万元；芯联越州持有部分为 54,520.00 万元；芯联先锋持有部分为 4,540.00 万元。

评估结论使用有效期：为评估基准日起壹年，即有效期至 2027 年 4 月 29 日截止。

特别事项说明：本次评估涉及其他等可能影响评估结论的特别事项，详见本报告正文的“特别事项说明”部分。

芯联集成电路制造股份有限公司及其子公司拟进行技术授权所涉及的

芯联集成电路制造股份有限公司及其子公司持有的部分资产

资产评估报告

正文

芯联集成电路制造股份有限公司及芯联先进集成电路制造（绍兴）有限公司：

金证（上海）资产评估有限公司接受贵方的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用收益法，按照必要的评估程序，对芯联集成电路制造股份有限公司及其子公司拟技术授权之经济行为所涉及的芯联集成电路制造股份有限公司、芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司、芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司部分无形资产在 2026 年 4 月 30 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：

一、委托人、产权持有人和其他资产评估报告使用人概况

（一）委托人

委托人 1

企业名称：芯联集成电路制造股份有限公司

证券代码：688469.SH

企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）

住 所：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号

法定代表人：赵奇

注册资本：人民币 838,268.7172 万元

经营范围：半导体（硅及各类化合物半导体）集成电路芯片制造、针测及测试、测试封装；先进晶圆级封装；电子元器件及光学元器件研发及制造；光刻掩膜版开发制造；模具制造与加工；与集成电路、电子/光学元器件有关的开发、设计服务、技术服务；销售自产产品，并提供相关技术咨询和技术服务；从事货物及技术的进出口业务；自有设备、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

委托人 2

企业名称：芯联先进集成电路制造（绍兴）有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：浙江省绍兴市柯桥区钱清街道联兴村 3 幢 108 室

法定代表人：赵奇

注册资本：人民币 1,000.00 万元

经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）产权持有人

产权持有人 1

企业名称：芯联集成电路制造股份有限公司（后文简称“芯联集成”）

证券代码：688469.SH

企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）

住 所：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号

法定代表人：赵奇

注册资本：人民币 838,268.7172 万元

经营范围：半导体（硅及各类化合物半导体）集成电路芯片制造、针测及测试、测试封装；先进晶圆级封装；电子元器件及光学元器件研发及制造；光刻掩膜版开发制造；模具制造与加工；与集成电路、电子/光学元器件有关的开发、设计服务、技术服务；销售自产产品，并提供相关技术咨询和技术服务；从事货物及技术的进出口业务；自有设备、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

产权持有人 2

企业名称：芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司（后文简称“芯联越州”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 508 号

法定代表人：赵奇

注册资本：人民币 398,282.0957 万元

经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；电力电子元器件制造；

电力电子元器件销售；电子元器件制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；住房租赁（限自有房屋）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

产权持有人 3

企业名称：芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司（后文简称“芯联先锋”）

企业类型：其他有限责任公司

住 所：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号-17

法定代表人：赵奇

注册资本：人民币 1,329,244.16 万元

经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电子元器件制造；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；（限自有房屋租赁）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人

资产评估委托合同约定无其他资产评估报告使用人。

除委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

二、评估目的

芯联集成电路制造股份有限公司及其子公司拟技术授权其拥有的部分无形资产，为此需要对芯联集成电路制造股份有限公司、芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司、芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司的部分无形资产价值进行评估，为上述经济行为提供价值参考依据。

三、评估对象和评估范围

本次评估对象为芯联集成电路制造股份有限公司、芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司、芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司拥有的部分无形资产。

本次评估范围为芯联集成电路制造股份有限公司、芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司、芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司拥有的专利权 66 项、专有技术 30 项。

纳入本次评估范围的无形资产-其他无形资产共计 96 项，包括专利权 66 项、专有技术 30 项，均在账面未反映。企业拥有的专利权及专有技术清单如下：

专利权清单

序号	权利人	专利号	专利名称	申请日期	授权公告日	专利类别	专利状态
1	中芯集成	ZL202210490443.8	振荡电路及电子设备	2022/5/7	2025/12/12	发明专利	授权
2	中芯集成	ZL202221140124.6	ESD 保护器件	2022/5/11	2022/8/26	实用新型	授权
3	中芯集成	ZL202210556009.5	半导体器件的版图结构	2022/5/24	2025/3/25	发明专利	授权
4	中芯集成	ZL202210526183.5	一种 SOI 晶圆及制造方法	2022/5/16	2025/9/19	发明专利	授权
5	中芯集成	ZL202210971682.5	静态随机存取存储器电路及电子产品	2022/8/12	2025/10/10	发明专利	授权
6	中芯集成	ZL202211092203.9	MOS 器件及具有该 MOS 器件的电路	2022/9/8	2023/6/2	发明专利	授权
7	中芯集成	ZL202211195626.3	一种衬底上的布局结构及其制备方法	2022/9/28	2025/6/20	发明专利	授权
8	中芯集成	ZL202211280779.8	集成电路版图的设计方法及系统、存储介质	2022/10/19	2025/12/19	发明专利	授权
9	中芯集成	ZL202211304854.X	金属氧化物半导体器件的制备方法及其器件	2022/10/24	2025/12/12	发明专利	授权
10	中芯集成	ZL202211502713.9	半导体集成电路及其制备方法	2022/11/29	2023/4/4	发明专利	授权
11	中芯集成	ZL202310136511.5	一种半导体器件及制造方法	2023/2/20	2024/2/27	发明专利	授权
12	中芯集成	ZL202311482294.1	晶体管器件和闪存存储器的集成结构及其集成方法	2023/11/9	2024/4/5	发明专利	授权
13	芯联集成	ZL202311675192.1	晶体管器件及其制备方法、半导体集成电路及其制备方法	2023/12/8	2024/5/24	发明专利	授权
14	芯联集成	ZL202311763818.4	半导体器件及其制作方法	2023/12/20	2024/5/10	发明专利	授权
15	芯联集成	ZL202410199362.1	半导体器件及其制备方法、半导体集成电路及其制备方法	2024/2/23	2024/5/24	发明专利	授权
16	芯联集成	ZL202410482236.7	半导体器件的制备方法及半导体器件	2024/4/22	2024/7/23	发明专利	授权
17	芯联集成	ZL202411293708.0	接触孔测试结构及其制造方法、检测接触孔过度刻蚀的方法和半导体器件结构	2024/9/14	2025/10/3	发明专利	授权
18	中芯集成	ZL202010556893.3	提高薄膜表面处理精度的方法及半导体器件的制造方法	2020/6/18	2020/10/27	发明专利	授权
19	中芯集成	ZL202010931963.9	半导体器件的制造方法	2020/9/8	2020/12/4	发明专利	授权
20	中芯集成	ZL202011082031.8	一种绝缘栅双极型晶体管及其形成方法	2020/10/12	2021/1/29	发明专利	授权
21	中芯集成	ZL202011045236.9	功率半导体器件及其制造方法	2020/9/29	2021/6/11	发明专利	授权
22	中芯集成	ZL202111224067.X	光刻方法和半导体器件的制造方法	2021/10/21	2022/1/28	发明专利	授权
23	中芯越州	ZL20191101883.X	温度补偿型表面声波滤波器件及其制造方法	2019/10/24	2022/8/26	发明专利	授权
24	中芯越州	ZL20201024499.X	半导体器件及其形成方法	2020/3/31	2022/9/9	发明专利	授权
25	中芯越州	ZL20221158598.1	外延结构、半导体器件及制备方法	2022/12/9	2025/7/25	发明专利	授权
26	中芯越州	ZL20221166787.1	一种异质结双极型晶体管及其制备方法	2022/12/23	授权待公告	发明专利	授权

序号	权利人	专利号	专利名称	申请日期	授权公告日	专利类别	专利状态
27	中芯越州	ZL20231016039.1	避免解键合印记的方法及功率器件的制备方法	2023/2/16	2026/2/3	发明专利	授权
28	中芯越州	ZL20231018065.2	一种多通道沟槽型 MOS 器件及其制备方法	2023/2/17	授权待公告	发明专利	授权
29	中芯越州	ZL20231034710.7	结型场效应晶体管制备方法及结型场效应晶体管	2023/3/29	2025/8/19	发明专利	授权
30	中芯越州	EP23741247..3	MOSFET 器件及其制造方法	2023/7/25	2025/9/24	发明专利	授权
31	中芯越州	JP202354602.8	MOSFET 器件及其制造方法	2023/7/27	2025/1/23	发明专利	授权
32	中芯越州	JP202357130.3	MOSFET 器件及其制造方法	2023/11/16	2025/8/1	发明专利	授权
33	芯联越州	ZL20241019556.8	滤波器及其制备方法	2024/2/22	2025/3/4	发明专利	授权
34	芯联越州	ZL20242057267.1	晶圆整平装置、晶圆清洗设备	2024/3/22	2024/12/3	实用新型	授权
35	芯联越州	ZL20242116845.6	用于刻蚀设备的边缘环及刻蚀设备	2024/5/27	2025/1/21	实用新型	授权
36	芯联越州	ZL20242122599.0	缺陷定位装置	2024/5/31	2025/2/21	实用新型	授权
37	芯联越州	ZL20241126706.4	半导体测试结构及其测试方法	2024/9/11	2025/1/28	发明专利	授权
38	芯联越州	ZL20242208557.3	离子注入机的晶圆夹持装置及离子注入机	2024/8/27	2025/7/22	实用新型	授权
39	芯联越州	ZL20242251452.X	位置校正治具及半导体设备	2024/10/17	2025/8/26	实用新型	授权
40	芯联越州	ZL20242250109.3	加热装置以及半导体制造设备	2024/10/16	2025/8/5	实用新型	授权
41	芯联越州	ZL20242274511.2	扩散炉装置	2024/11/11	2025/9/26	实用新型	授权
42	芯联越州	ZL20242276671.0	散流装置及刻蚀设备	2024/11/13	2025/11/4	实用新型	授权
43	芯联越州	ZL20241164997.8	一种半导体器件及其制造方法、电子装置	2024/11/19	2025/3/21	发明专利	授权
44	芯联越州	ZL20242313662.9	多电压输出的 UPS 系统	2024/12/18	2025/11/28	实用新型	授权
45	芯联越州	ZL20241195312.2	曝光补偿方法及装置、曝光方法及机台	2024/12/27	2025/9/23	发明专利	授权
46	芯联越州	ZL20241196740.3	半导体器件的制备方法和半导体器件	2024/12/30	2025/9/23	发明专利	授权
47	芯联越州	ZL20251001918.5	半导体测试结构	2025/1/7	2025/4/25	发明专利	授权
48	芯联越州	ZL20252024591.9	晶体管和半导体集成结构	2025/2/17	2026/1/30	实用新型	授权
49	芯联越州	ZL20252065184.0	高电子迁移率晶体管	2025/4/8	授权待公告	实用新型	授权
50	芯联越州	ZL20252021403.X	传片切换装置及刻蚀设备	2025/2/11	2025/12/30	实用新型	授权
51	芯联越州	ZL20252098293.2	刻蚀容器及刻蚀设备	2025/5/19	授权待公告	实用新型	授权
52	芯联越州	ZL20252103210.1	基片固定装置及气相沉积设备	2025/5/23	授权待公告	实用新型	授权
53	芯联越州	ZL20252104939.3	拆装治具	2025/5/26	授权待公告	实用新型	授权
54	芯联越州	ZL20252129614.8	晶舟运动装置	2025/6/23	授权待公告	实用新型	授权
55	芯联越州	ZL20251132661.6	半导体结构及其制造方法	2025/9/17	2025/11/28	发明专利	授权
56	芯联越州	ZL20251196343.X	晶圆处理方法及半导体器件	2025/12/24	授权待公告	发明专利	授权
57	芯联先锋	ZL202410296168.5	一种静电放电保护电路和集成电路芯片	2024/3/15	2024/5/28	发明专利	授权
58	芯联先锋	ZL202520032296.9	电源箝位电路和芯片	2025/1/7	2025/12/26	实用新型	授权
59	中芯先锋	ZL202210525998.1	半导体器件	2022/5/16	2022/8/26	发明专利	授权

序号	权利人	专利号	专利名称	申请日期	授权公告日	专利类别	专利状态
60	中芯先锋	ZL202310182769.9	电平位移器、半导体器件及其制备方法	2023/3/1	2023/5/30	发明专利	授权
61	中芯先锋	ZL202320777802.8	电迁移测试系统	2023/4/10	2023/7/18	实用新型	授权
62	中芯先锋	ZL202310396519.5	衬底处理方法及半导体器件制造方法	2023/4/13	2023/10/20	发明专利	授权
63	中芯先锋	ZL202321534375.7	电平位移器和半导体器件	2023/6/15	2024/2/27	实用新型	授权
64	芯联先锋	ZL202411463528.2	电平转换电路	2024/10/21	2025/3/11	发明专利	授权
65	芯联先锋	ZL202411509016.5	半导体器件的版图结构	2024/10/28	2025/4/29	发明专利	授权
66	芯联先锋	ZL202411545757.9	IGBT 晶圆的制备方法及 IGBT 晶圆	2024/11/1	2025/7/8	发明专利	授权

专有技术清单

序号	权利人	专有技术名称
1	芯联越州	一种传统 CMOS 与 eflash 的工艺兼容优化方案
2	芯联越州	一种改善 HV MOS 晶体管 Bulk 漏电的方法
3	芯联越州	一种减少 12V 高压器件光刻胶残留的方法
4	芯联越州	一种减少 STI void 缺陷的方法
5	芯联越州	一种提高耐压并减小芯片面积的闪存结构设计
6	芯联越州	一种提高闪存性能的方法
7	芯联越州	一种提升 Eflash3 代工艺窗口与读擦写稳定性的方法
8	芯联越州	一种多晶硅栅极刻蚀工艺优化方法
9	芯联越州	一种 PMOS NBTI 提升的栅氧优化技术
10	芯联越州	一种采用原位蒸汽生成氧化降低 40nm MOS 晶体管接触电阻的方法
11	芯联越州	一种低 k 介质材料介电常数 (k 值) 优化方法
12	芯联越州	一种改善 Cu 工艺后段应力迁移的技术方案
13	芯联越州	一种优化 NiSi 尖峰退火工艺防止栅极分解的技术方案
14	芯联越州	一种优化单晶片退火提高后段工艺可靠性的技术方案
15	芯联越州	一种在应力记忆技术中沉积拉应力氮化硅方式
16	芯联越州	一种 SOI 晶圆翘曲改善的工艺方法
17	芯联越州	一种电源高边应用的功率管技术方案
18	芯联越州	一种基于 SOI 晶圆的电平位移技术方案
19	芯联越州	一种基于 SOI 晶圆的 HWC (handle wafer contact)技术方案
20	芯联越州	一种基于 SOI 晶圆的 DUP (Device Under Pad)技术方案
21	芯联越州	一种基于 SOI 晶圆的高精度齐纳二极管技术方案
22	芯联越州	一种集成在 BCD 后段的深沟槽高密度电容 (DTC)
23	芯联越州	一种降低 BCD NLD MOS 导通电阻的技术方案
24	芯联越州	一种 DTI 双环高压电性隔离结构
25	芯联越州	一种监测 LDMOS RO 鸟嘴长度的测试结构
26	芯联越州	一种超高压的隔离器电容
27	芯联越州	一种提升 LDMOS 开态电性的技术方案
28	芯联越州	一种基于组合 CMP 工艺的 IGBT 多晶硅栅极制造方法
29	芯联越州	一种 IGBT CONT 形貌优化改善填充能力及增强抗门锁能力的技术方案
30	芯联越州	一种多层 METAL 一体化刻蚀优化改善封装打线及改善 PA Crack 优化抗湿气能力的技术方案

四、价值类型

经与委托人沟通，考虑评估目的、市场条件、评估对象自身条件等因素，本次评估选取的价值类型为市场价值。

市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

五、评估基准日

本项目评估基准日是 2026 年 4 月 30 日。

评估基准日是由委托人在考虑经济行为的实现等因素的基础上确定的。

六、评估依据

(一) 法律法规依据

1. 《中华人民共和国资产评估法》(2016 年 7 月 2 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过);
2. 《中华人民共和国企业国有资产法》(2008 年 10 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过);
3. 《国有资产评估管理办法》(国务院令第 91 号公布, 国务院令第 732 号修改);
4. 《国有资产评估管理办法施行细则》(原国家国有资产管理局国资办发[1992]36 号);
5. 《企业国有资产评估管理暂行办法》(国资委令第 12 号);
6. 《企业国有资产交易监督管理办法》(国务院国资委、财政部令第 32 号);
7. 《国有资产评估管理若干问题的规定》(财政部令第 14 号);
8. 《关于加强企业国有资产评估管理工作有关问题的通知》(国资委产权[2006]274 号);
9. 《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院令第 378 号公布, 国务院令第 709 号修正);
10. 《中华人民共和国专利法》(1984 年 3 月 12 日第六届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过, 2020 年 10 月 17 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议修正);
11. 其他有关法律法规。

(二) 评估准则依据

1. 《资产评估基本准则》(财资[2017]43 号);
2. 《资产评估职业道德准则》(中评协[2017]30 号);
3. 《资产评估执业准则——资产评估程序》(中评协[2018]36 号);

4. 《资产评估执业准则——资产评估报告》(中评协[2018]35号);
5. 《资产评估执业准则——资产评估委托合同》(中评协[2017]33号);
6. 《资产评估执业准则——资产评估档案》(中评协[2018]37号);
7. 《资产评估执业准则——无形资产》(中评协[2017]37号);
8. 《资产评估执业准则——资产评估方法》(中评协[2019]35号);
9. 《资产评估执业准则——知识产权》(中评协[2023]14号);
10. 《资产评估机构业务质量控制指南》(中评协[2017]46号);
11. 《资产评估价值类型指导意见》(中评协[2017]47号);
12. 《资产评估对象法律权属指导意见》(中评协[2017]48号);
13. 《专利资产评估指导意见》(中评协[2017]49号);
14. 其它相关行业规范。

(三) 权属依据

1. 专利证书;
2. 其他权属证明文件。

(四) 取价依据

1. 企业提供的项目可行性研究报告;
2. 中央国债登记结算有限责任公司编制,并在中国债券信息网发布的国债到期收益率数据;
3. 中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR);
4. 企业管理层提供的未来收益预测资料;
5. 国家宏观经济、行业、区域市场及企业统计分析资料;
6. 其他相关取价依据。

(五) 其他参考依据

1. 企业提供的资产清单、评估申报表和四期项目收入预测;
2. 企业提供的原始财务报表、账册、会计凭证;
3. 企业提供的经营信息和资料;
4. 评估人员现场调查记录及收集的其他相关信息和资料;
5. 金证(上海)资产评估有限公司技术资料库;
6. 评估基准日有效的企业会计准则及应用指南;
7. 其它有关参考依据。

七、评估方法

资产评估的基本方法包括市场法、收益法和成本法。

市场法是指通过将评估对象与可比参照物进行比较，以可比参照物的市场价格为基础确定评估对象价值的评估方法。

收益法是指通过将评估对象的预期收益资本化或者折现来确定其价值的评估方法。

成本法是指按照重建或者重置被评估对象的思路，将重建或者重置成本作为确定评估对象价值的基础，扣除相关贬值，以此确定评估对象价值的评估方法。

对评估范围内各项资产的评估方法介绍如下：

1. 无形资产

(1) 其他无形资产——专利、专有技术

对于专利、专有技术，本次采用收益法（收入分成法）评估，在预测未来与技术相关的营业收入基础上，采用收入分成率估算技术类无形资产对销售收入的贡献额，并采用适当的折现率折为现值，以此确定技术类无形资产的评估值，基本公式如下：

$$V = \sum_{i=1}^n \frac{F_i \times K_i}{(1+r)^i}$$

其中：V—技术评估值；

r—技术的折现率；

n—技术的收益期限；

F_i—未来第i期与技术相关的营业收入；

K_i—未来第i期技术的收入分成率；

八、评估程序实施过程和情况

自接受资产评估业务委托起至出具资产评估报告，主要评估程序实施过程和情况如下：

(一) 明确业务基本事项

与委托人进行接洽，明确以下资产评估业务基本事项：(1) 委托人、产权持有人和委托人以外的其他资产评估报告使用人；(2) 评估目的；(3) 评估对象和评估范围；(4) 价值类型；(5) 评估基准日；(6) 资产评估项目所涉及的需要批准的经济行为的审批情况；(7) 资产评估报告使用范围；(8) 资产评估报告提交期限及方式；(9) 评估服务费及支付方式；(10) 委托人、其他相关当事人与资产评估机构及其资产评估专业人员工作配合和协助等需要明确的重要事项。

(二) 订立业务委托合同

在业务基本事项的基础上，对专业能力、独立性和业务风险进行综合分析和评价。在确保受理该资产评估业务满足专业能力、独立性和业务风险控制要求的情况下，与委托人

签订资产评估委托合同，约定资产评估机构和委托人权利、义务、违约责任和争议解决等内容。

（三）编制资产评估计划

根据资产评估业务具体情况编制资产评估计划，包括资产评估业务实施的主要过程及时间进度、人员安排等。

（四）进行评估现场调查

采用询问、访谈、核对、等手段，对评估对象进行现场调查，获取评估业务需要的资料，了解评估对象现状，关注评估对象法律权属。

（五）收集整理评估资料

根据资产评估业务具体情况，收集资产评估业务需要的资料，主要包括：（1）委托人或者其他相关当事人提供的涉及评估对象和评估范围等资料；（2）从政府部门、各类专业机构以及市场等渠道获取的其他资料。采用观察、询问、书面审查、实地调查、查询、函证、复核等方式，对资产评估活动中使用的资料进行核查验证。根据资产评估业务具体情况对收集的评估资料进行分析、归纳和整理，形成评定估算和编制资产评估报告的依据。

（六）评定估算形成结论

根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等情况，分析市场法、收益法和成本法三种资产评估基本方法及衍生方法的适用性，选择评估方法。在此基础上，根据所采用的评估方法，选取相应的公式和参数进行分析、计算和判断，形成测算结果，并对形成的测算结果进行综合分析，形成评估结论。

（七）编制出具评估报告

资产评估专业人员在评定、估算形成评估结论后，编制初步资产评估报告。资产评估机构按照法律、行政法规、资产评估准则和资产评估机构内部质量控制制度，对初步资产评估报告进行内部审核。项目负责人根据内部审核意见对初步资产评估报告进行修改和完善后，在不影响对评估结论进行独立判断的前提下，与委托人或者委托人同意的其他相关当事人就资产评估报告有关内容进行沟通，根据沟通结果对资产评估报告进行合理完善后，出具并提交正式资产评估报告。

九、评估假设

本资产评估报告分析估算采用的假设条件如下：

（一）一般假设

1.交易假设：即假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。

2.公开市场假设：即假定资产可以在充分竞争的市场上自由买卖，其价格高低取决于一定市场的供给状况下独立的买卖双方对资产的价值判断。

3.现状利用假设：即一项资产按照其目前的利用状态及利用方式对其价值进行评估。

(二) 特殊假设

- 1.假设评估基准日后产权持有人所处国家和地区的政治、经济和社会环境无重大变化；
- 2.假设评估基准日后国家宏观经济政策、产业政策和区域发展政策除公众已获知的变化外，无其他重大变化；
- 3.假设与产权持有人相关的税收政策、信贷政策不发生重大变化，税率、汇率、利率、政策性征收费用率基本稳定；
- 4.假设评估基准日后产权持有人的管理层是负责的、稳定的，且有能力担当其职务；
- 5.假设产权持有人完全遵守所有相关的法律法规，不会出现影响公司发展和收益实现的重大违规事项；
- 6.假设委托人及产权持有人提供的基础资料、财务资料 and 经营资料真实、准确、完整；
- 7.假设评估基准日后无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对产权持有人造成重大不利影响；
- 8.假设评估基准日后被评估单位的现金流入为平均流入，现金流出为平均流出。

本评估报告评估结论在上述假设条件下在评估基准日时成立，当上述假设条件发生较大变化时，签字资产评估师及本评估机构将不承担由于假设条件改变而推导出不同评估结论的责任。

十、评估结论

(一) 无形资产评估结果

采用收益法评估，纳入本次评估范围的无形资产账面价值为 0.00 万元，评估价值 90,870.00 万元，增值额 90,870.00 万元。每家公司的具体金额如下：

单位：万元

公司	评估值	大写金额
芯联集成电路制造股份有限公司	31,810.00	叁亿壹仟捌佰壹拾万元整
芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司	54,520.00	伍亿肆仟伍佰贰拾万元整
芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司	4,540.00	肆仟伍佰肆拾万元整
合计	90,870.00	玖亿零捌佰柒拾万元整

(二) 评估结论的使用有效期

本评估报告所揭示的评估结论仅对评估报告中描述的经济行为有效，评估结论使用有效期为自评估基准日起一年，即自评估基准日 2026 年 4 月 30 日至 2027 年 4 月 29 日。

十一、特别事项说明

以下为在评估过程中已发现可能影响评估结论但非评估人员执业水平和能力所能评定估算的有关特别事项，评估报告使用人应关注以下特别事项对评估结论和经济行为产生的影响。

（一）引用其他机构出具报告结论的情况

本次评估无直接引用其他机构出具报告结论的情况。

（二）权属资料不全面或者存在瑕疵的情形

本次评估未发现权属资料不全面或者存在瑕疵的情形。

（三）评估程序受到限制的情形

本次评估无评估程序受到限制的情形。

（四）评估资料不完整的情形

本次评估未发现重要评估资料存在不完整的情形。

（五）评估基准日存在的法律、经济等未决事项

本次评估未发现评估基准日存在法律、经济等未决事项。

（六）担保、租赁及其或有负债（或有资产）事项

本次评估未发现担保、租赁及其或有负债（或有资产）事项。

（七）评估基准日至资产评估报告日之间可能对评估结论产生影响的事项

本次评估在评估基准日至资产评估报告日之间未发现可能对评估结论产生影响的重大期后事项。

（八）本次经济行为中可能对评估结论产生重大影响的瑕疵情形

在本次资产评估对应的经济行为中，未发现可能对评估结论产生重大影响的瑕疵情形。

（九）其他需要说明的事项

本次评估结论不含增值税。

委估无形资产中 17 项专利证书证载专利权人为“绍兴中芯集成电路制造股份有限公司”、10 项专利证书证载专利权人为“中芯越州集成电路制造（绍兴）有限公司”、5 项专利证书证载专利权人为“中芯先锋集成电路制造（绍兴）有限公司”，其分别为产权持有人“芯联集成电路制造股份有限公司”、“芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司”、“芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司”的曾用名，截止评估基准日尚未办理名称变更。该事项对专利使用不会产生实质影响，本次评估未考虑相关事项对评估结论可能产生的影响，提请报告使用人关注。

评估师执行资产评估业务的目的是对评估对象价值进行估算并发表专业意见，并不承担相关当事人决策的责任。评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。

委托人及产权持有人所提供的资料是进行本次资产评估的基础，委托人及产权持有人应对所提供资料的真实性、合法性和完整性承担责任。

十二、资产评估报告使用限制说明

本资产评估报告的使用范围如下：仅供委托人和资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人使用；仅限用于本资产评估报告载明的评估目的；仅限在本资产评估报告载明的评估结论使用有效期内使用；未征得本资产评估机构同意，资产评估报告的内容不得被摘抄、引用或者披露于公开媒体，法律、行政法规规定以及相关当事人另有约定的除外。

委托人或者其他资产评估报告使用人未按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估师不承担责任。

除委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。

本资产评估报告经资产评估师签字、评估机构盖章后方可正式使用。

十三、资产评估报告日

资产评估报告日为 2026 年 6 月 6 日。

（此页以下无正文）

(本页无正文,系金证评报字【2026】A0533号资产评估报告签章页)

资产评估机构:金证(上海)资产评估有限公司



资产评估师:

Handwritten signature of Lin Xiao in black ink.

Handwritten signature of Gong Wei in black ink.



资产评估报告日: 2026年6月6日

地址: 上海市徐汇区龙兰路 277 号东航滨江中心 T3 座 7 楼 邮编: 200232
电话: 021-63081130 传真: 021-63081131 电子邮箱: contact@jzvaluation.com

附 件

- 附件一、 委托人和产权持有人营业执照
- 附件二、 评估对象涉及的主要权属证明资料
- 附件三、 委托人和产权持有人的承诺函
- 附件四、 签名资产评估师的承诺函
- 附件五、 资产评估机构法人营业执照副本
- 附件六、 资产评估机构备案文件或者资格证明文件
- 附件七、 签名资产评估师资格证明文件
- 附件八、 资产评估委托合同
- 附件九、 资产账面价值与评估结论存在较大差异的说明
- 附件十、 资产评估汇总表